

即時發布

投資者關係

Ed Lockwood

投資者關係高級總監

(408) 875-9529

ed.lockwood@kla-tencor.com

媒體關係

Becky Howland, 博士

企業通訊高級總監

(408) 875-9350

becky.howland@kla-tencor.com

KLA-Tencor 宣布推出 Kronos™ 1080 和 ICOS™ F160 檢測系統： 拓展 IC 封裝產品系列

加利福尼亞州米爾皮塔斯，2018 年 8 月 30 日 - [KLA-Tencor 公司](#)（納斯達克股票代碼：KLAC）今日宣布推出兩款全新缺陷檢測產品，旨在解決各類積體電路（IC）所面臨的封裝挑戰。**Kronos™ 1080** 系統為先進封裝提供適合量產的、高靈敏度的晶圓檢測，為製程控制和材料處置提供關鍵的信息。**ICOS™ F160** 系統在晶圓切割後對封裝進行檢查，根據關鍵缺陷的類型進行準確快速的晶片分類，其中包括對側壁裂縫這一新缺陷類型（影響高端封裝良率）的檢測。這兩款全新檢測系統加入 KLA-Tencor 的缺陷檢測、量測和資料分析系統的產品系列，將進一步協助提高封裝良率以及晶片分類精度。

“隨著晶片縮小的速度逐漸放緩，晶片封裝技術的進步已成為推動元件性能的重要因素，” KLA-Tencor 高級副總裁兼首席營銷官 Oreste Donzella 表示。“針對不同的元件應用，封裝晶片需要同時滿足各種元件性能、功耗、外形尺寸和成本的目標。因此，封裝設計更加複雜多樣，具有不同的 2D 和 3D 結構，並且每一代都更加密集而且尺寸更小。與此同時，封裝晶片的價值在大幅增長，電子製造商對於產品質量和可靠性的期望也在不斷地提升。為了滿足這些期望，無論是晶片製造廠的後端還是在外包封裝測試（OSAT）的工廠，都需要靈敏度和成本效益更高的檢測、量測和資料分析，同時需要更準確地識別殘次品。我們的工程團隊因而開發出全新 Kronos 1080 和 ICOS F160 系統，可以針對各種封裝類型，滿足電子行業對於適合量產的缺陷檢測不斷增長的需求。”

Kronos 1080 系統旨在檢測先進的晶圓級封裝製程步驟，為在線製程控制提供各種缺陷類型的消息。先進的封裝技術必然包含更小的特徵、更高密度的金屬圖案和多層再分佈層 - 所有這些都對檢測不斷地提出更高要求，並要求創新的解決方案。Kronos 系統採用多模光學系統和感測器以及先進的缺陷檢測演算法，並實現了領先業界的性能。Kronos 系統還引入了 FlexPoint™，這一項源自 KLA-Tencor 領先的 IC 晶片製造檢測解決方案的先進技術。FlexPoint 將檢測集中在晶片內缺陷會產生最大影響的關鍵區域。靈活的晶圓處理能夠檢測高度翹曲晶圓，這經常會出現這扇外型晶圓級封裝中 - 該封裝製程對移動裝置應用已是廣泛運用的技術，並是網絡和高效計算應用中的新興的封裝技術。

晶圓級封裝通過測試和切割之後，**ICOS F160** 執行檢測和晶片分類。高端封裝（如移動裝置應用）的製造商，將受益於系統的新功能 -- 檢測激光刻槽、髮絲裂縫和側壁裂縫。這是由密集金屬佈線上的所採用為了提高速度並降低功耗的新絕緣材料引起的。新材料易碎，使其在晶圓切割過程中容易出現裂縫。眾所周知，側壁裂縫非常難以檢測，因為它們垂直於晶片表面，因而無法用傳統的目測檢測發現。**ICOS F160** 系統的靈活性也是其另外一優勢，使其有利於許多封裝類型：輸入和輸出模式可以是晶圓、托盤或磁帶。系統可以輕鬆地從一種設置改換到另一種設置。其自動校準和精準晶片挑檢也有助於提高批量製造環境中的設備利用率。

Kronos 1080 和 **ICOS F160** 系統是 KLA-Tencor 的封裝解決方案系列產品的一部分，旨在滿足各種 IC 封裝類型的檢測、量測、資料分析和晶片分類的需求。該系列產品包括 [CIRCL™-AP](#) 全表面晶圓檢測系統，用於晶圓和面板的 [Zeta-580/680](#) 3D 量測系統，**ICOS™ T890**，**T3** 和 **T7 系列** 元件檢測和量測系統，以及 [Klarity®](#) 資料分析系統。有關這兩種新型缺陷檢測系統和 KLA-Tencor 完整的封裝解決方案系列產品的更多訊息，請參見[封裝系列產品的網頁](#)。

關於 KLA-Tencor:

KLA-Tencor 公司是全球領先的製程控制及良率管理解決方案的設備供應商。該公司與全球的客戶合作，開發最先進的檢測和量測技術，致力服務於半導體及其他相關奈米電子工業。憑藉業界標準產品組合和世界一流的工程師科學家團隊，公司 40 餘年來持續為客戶打造卓越的解決方案。KLA-Tencor 公司的總部位於加利福尼亞州米爾皮塔斯市（Milpitas），並在全球設有專屬的客戶運營和服務中心。更多相關信息，請訪問公司網站 <http://www.kla-tencor.com> (KLAC-P)。

前瞻性聲明:

本新聞稿中除歷史事實以外的聲明，例如關於 **Kronos 1080** 和 **ICOS F160** 系統的預期性能以及缺陷減少和晶片精確分類為封裝製造設施所帶來的經濟影響都是前瞻性陳述，並且符合《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）中“安全港”（Safe Harbor）條款的規定。這些前瞻性聲明基於目前資訊及預期，並且受到諸多風險與不確定性影響。由於各種實際因素，例如（由於成本、性能抑或其他原因造成的）新技術推遲、其他公司推出競爭性產品、或影響 KLA-Tencor 產品的實施、性能或使用的意外技術挑戰或限制等影響，實際結果可能與此類聲明中的預計結果大不相同。

###